

# 新世代GPUの運用に合わせてシステム全体の性能向上を図った 新世代AI開発用途向けワークステーション

最大  
**64**  
Core

PCI-  
Express  
**Gen4**

**2**  
GPU



AI開発向けワークステーション  
**PAW-300**

- AMD EPYC™ 7002 シリーズ・プロセッサ( Rome)搭載
- 8ch高速メモリアクセス、PCI-Express Gen4などの広帯域のデータ転送に対応
- NVIDIA GeForce RTX™ 3080/3090などの3スロットクーラーGPUを2基搭載可能
- 10GbEイーサネット、ECC Registeredメモリ、IPMIなどプロフェッショナル用途向け機能搭載



NVIDIA GeForce RTX™ 3080 および NVIDIA GeForce RTX™ 3090に対応  
AI/ディープラーニング開発に向け最適化されたワークステーション

「PAW-300」は最大64コアのAMD EPYC™ 7002 シリーズ・プロセッサ、8chメモリアクセス、PCI-Express Gen4などを採用しシステム全体の性能向上を図ることで、最新GPUのパフォーマンスを引き出し、AI/ディープラーニング開発を推進します。

※写真はイメージです。

PAW-300 は、CPU、メモリ容量/ストレージ容量/GPU 本数/OS の変更など柔軟なカスタマイズに対応、お客様のご希望に適したコストでの導入をサポートします。

## ■製品仕様

OS	[Deep Learning 構成] Ubuntu 18.04 LTS (推奨OS) [GPGPU 構成] CentOS 7 x86_64 (推奨OS) Red Hat Enterprise Linux 7 x86_64 Deep Learning向けSIサービスを標準セットアップ	Windows 10 Pro for Workstations ※Deep Learning向けサービスについてはご相談ください。 「Secure Processor」用のWindows10ドライバが無いため、以下の機能はお使い 頂けません。 ・Secure Memory Encryption(メモリ上のデータの暗号化) ・Secure Encrypted Virtualization(仮想マシンの暗号化)
プロセッサ	AMD EPYC™ 7002シリーズ EPYC™ 7F72 24C/48T 3.2G 192M 240W (簡易水冷) EPYC™ 7F52 16C/32T 3.5G 256M 240W (簡易水冷) EPYC™ 7702P 64C/128T 2.0G 256M 200W EPYC™ 7502P 32C/64T 2.5G 128M 180W EPYC™ 7402P 24C/48T 2.8G 128M 180W EPYC™ 7302P 16C/32T 3.0G 128M 155W EPYC™ 7232P 8C/16T 3.1G 32M 120W	
プロセッサ搭載数	1CPU(最大 64 コア、最大TDP240W)	
プロセッサ冷却方式	空冷式 (TDP:225W以内) 簡易水冷式 (TDP:240W以内)	
チップセット	System on Chip (SoC)	
メモリスロット	256GB (32GB DDR4-3200 ECC Registered × 8) 128GB (16GB DDR4-3200 ECC Registered × 8) 64GB (8GB DDR4-3200 ECC Registered × 8) 8DIMMスロット/DDR4-3200 ECC Registered (8GB,16GB,32GB)	
内蔵ストレージ	SSD: M.2 ×1 (NVMe PCIe Gen4 / SATA)、U.2 ×2(Pcie Gen3 ※Gen4 TBD)	
内蔵ストレージ最大容量	2TB(2TB SATA HDD × 1)、TBD(U.2 )	
光学ドライブ	搭載不可	
グラフィックス	オンボードVGA(AST2500)	
GPUカード	NVIDIA GeForce RTX™ 3080/3090などの3スロットクーラーGPUを2基搭載可能	
インターフェイス	VGA [D-sub15 ピン] (背面) × 1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。 USB3.0 (前面 × 2) USB3.1 Gen2 (背面 × 2)、USB3.1 Gen2 Type-C (背面 × 1) 10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) × 2 シリアルポート (背面 × 1) IPMI2.0 ポート [RJ45] (背面) × 1	VGA [D-sub15 ピン] (背面) × 1 USB3.0 (前面 × 2) USB3.1 Gen2 (背面 × 2)、USB3.1 Gen2 Type-C (背面 × 1) 10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) × 2 シリアルポート (背面 × 1) IPMI2.0 ポート [RJ45] (背面) × 1
拡張スロット	PCI-Express 4.0 (x16) × 7(内1本はSwitchを経由しM.2、U.2とレーン分割して共有します)	
電源ユニット	100V 環境 1300W / 200V環境 1600W (80PLUS TITANIUM 認証取得)	
ACケーブル	100V用AC ケーブルを1本添付 / IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P	
ACコネクタタイプ	IEC 320-C14	
最大消費電力	約1000W	
筐体タイプ	タワー型 (ラックマウント非対応)	
サイズ (H×W×D)	465 mm × 272 mm × 476 mm	
重量	-	
付属品	100V用AC ケーブル × 1 USBキーボード (英語) × 1 USB光学式スクロールマウス × 1 取扱説明書 保証書	
保証	1年間センドバック保守	



### HPCシステムズ株式会社

〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階  
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL : 03-5446-5531 mail : hpcs\_sales@hpc.co.jp

WEBサイト : <https://hpc.co.jp/>

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。Microsoft、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

2022年8月現在の内容です。